



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

晶圆代工行业全线回暖，大尺寸电视面板有望推动显示面积需求增长

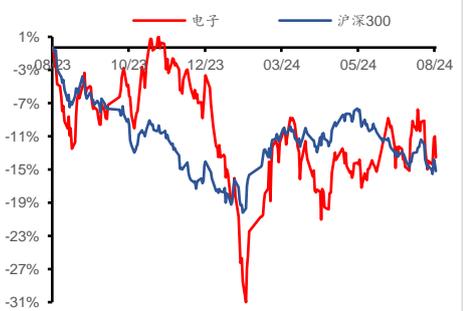
——电子行业周报（2024.07.29-2024.08.02）

增持（维持）

行业： 电子
日期： 2024年08月05日

分析师： 马永正
Tel: 021-53686147
E-mail: mayongzheng@shzq.com
SAC 编号: S0870523090001
联系人： 陈凯
Tel: 021-53686412
E-mail: chenikai@shzq.com
SAC 编号: S0870123070004
联系人： 杨蕴帆
Tel: 021-53686417
E-mail: yangyunfan@shzq.com
SAC 编号: S0870123070033

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《折叠屏迎来高端机型与实力选手，内外因素持续推动半导体设备&材料国产化》

——2024年07月29日

《雷朋 Meta 智能眼镜掀起新热潮，全球智能手机市场连续三个季度反弹》

——2024年07月22日

《中国智能手机 OLED 出货量有望稳步提升，半导体设备展现成长潜力》

——2024年07月15日

核心观点

市场行情回顾

过去一周（07.29-08.02），SW 电子指数上涨 0.48%，板块整体跑赢沪深 300 指数 1.21 pcts，从六大子板块来看，其他电子 II、光学光电子、半导体、电子化学品 II、消费电子、元件涨跌幅分别为 4.36%、1.49%、1.47%、0.87%、-1.37%、-2.65%。

核心观点

晶圆代工：受益 AI/HPC 需求激增&趋势逆转，晶圆代工厂产能利用率全面回升。7月31日，三星电子在其投资人财报会议上表示，半导体业务中的晶圆代工在 2024 年第二季度持续获利增长。三星晶圆代工提到，2024 年由于 5nm 以下先进技术中第二代 3nm GAA 技术的全面量产，预期营收增长将超过市场水准。据台媒报道台积电除先进制程 3nm、4/5nm 持续满载运转，成熟制程 22/28nm 产能利用率也正回归。晶圆代工厂世界先进总经理尉济时提到，在电源管理芯片需求持续增长下，2024Q3 产能利用率有望由 2024Q2 的 62% 回升至约 70%。台湾晶圆代工厂 2024 年上半年产能利用率 60%-65%，预估下半年将恢复到 75%-80%。与此同时，随着中国大陆晶片国产化率持续提升，带动陆系晶圆代工厂产能利用率也大幅回升，其中中芯国际等产能利用率已接近满载容量，且据半导体行业观察援引台湾工商时报消息，华虹半导体的晶圆厂目前产能利用率已超过 100%，合肥晶合的产能利用率 6 月也已达到 110%。

半导体产业已经历超过一年以上的库存调节，展望 2024H2，AI 助力各项应用兴起，全球半导体产业逐渐回温，据三星预计，受到移动需求反弹和 AI/HPC 需求激增，整个代工市场，尤其是先进技术有望实现增长。尽管成熟制程竞争依旧激烈，但可以观察到中国成熟制程晶圆代工厂“内卷”逐步迈入尾声，价格走势有望逆转；台湾成熟制程效能逐渐提升，联电、世界先进、力积电等主攻晶圆代工成熟制程的厂商报价也在同步看涨。因此我们认为，随着 AI 拉动的相关产业及本土半导体国产化率提升，全球及中国晶圆代工产业产能利用率逐步回升及代工价格有望持续回暖，各大代工厂业绩也有望回升。

生产效率提升&显示面板技术进步带动大尺寸显示面板需求，2024 年全球显示面积需求有望实现 8% 同比增长。2024 年，显示面板单位数量需求增长率预计将与 2023 年相近，约为 1%。然而，由于生产效率的提升和显示面板技术的不断进步，大尺寸显示面板面临的需求预计将稳步增长。据 Omdia 显示研究高级首席分析师 Ricky Park 表示，市场正在朝着显著扩大消费者需求的方向转变，且由于生产效率的提升和良品率的改进，面板的供应价格正逐渐走低。预计在今年下半年的旺季，这些面板将以更具吸引力的价格投放市场。Omdia 预测显示，面板厂商 2024 年计划出货 780 万块 80 英寸或更大尺寸的电视面板，同比增长 35%。2024 年，在整个显示面板市场中，80 英寸以上尺寸的显示面板预计占据的面积比例约为 7%，到 2030 年，这一比例预计将增长至 11%。鉴于投资大于第 10 代线（Gen10）的工厂不再具有挑战性，面板厂商将充分利用现有的第 8 代（Gen8）或第 10 代线工厂。随着需求的增加，这些工厂的运营率预计将显著提升。

投资建议

维持电子行业“增持”评级，我们认为目前电子半导体行业处于周期底部，2024 年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时

IPO 新规下，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。我们当前建议关注：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低 PE/PEG 的个股，AIOT SoC 芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片建议关注美芯晟和南芯科技；建议关注驱动芯片领域峰昭科技和新相微；Miniled 电影屏建议关注奥拓电子；半导体设备材料建议关注华海诚科和昌红科技；折叠机产业链建议关注统联精密及金太阳；建议关注军工电子紫光国微和复旦微电；建议关注华为供货商汇创达。

■ 风险提示

中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。

目 录

1 市场回顾	4
1.1 板块表现	4
1.2 个股表现	5
2 行业新闻	6
3 公司公告	8
4 风险提示	9

图

图 1: SW 一级行业周涨跌幅情况 (07.29-08.02)	4
图 2: SW 电子二级行业周涨跌幅情况 (07.29-08.02)	4
图 3: SW 电子三级行业周涨跌幅情况 (07.29-08.02)	5

表

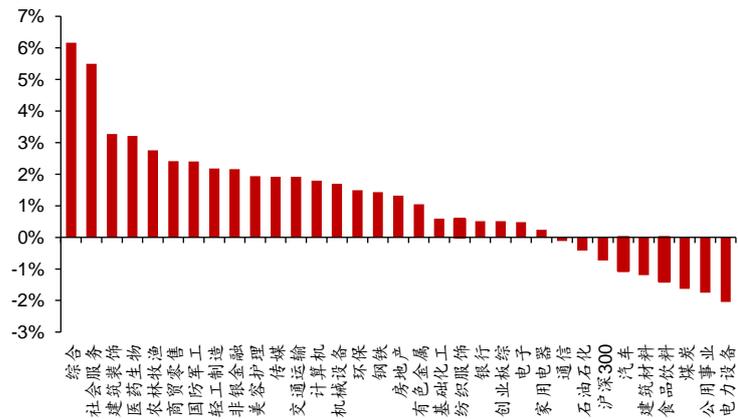
表 1: 电子板块 (SW) 个股过去一周涨跌幅前 10 名 (07.29-08.02)	5
表 2: 本周 A 股公司核心公告 (07.29-08.02)	8

1 市场回顾

1.1 板块表现

过去一周（07.29-08.02），SW 电子指数上涨 0.48%，板块整体跑赢沪深 300 指数 1.21 pcts、跑输创业板综指数 0.04 pcts。在 31 个子行业中，电子排名第 22 位。

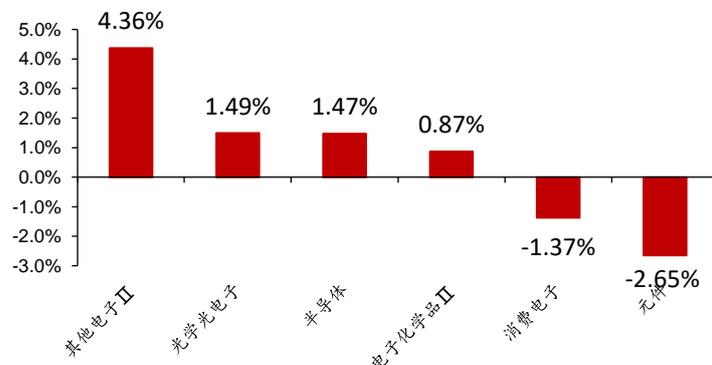
图 1：SW 一级行业周涨跌幅情况（07.29-08.02）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

过去一周（07.29-08.02）SW 电子二级行业中，其他电子 II 板块上涨 4.36%，涨幅最大；跌幅最大的是元件板块，下跌 2.65%。其他电子 II、光学光电子、半导体、电子化学品 II、消费电子、元件涨跌幅分别为 4.36%、1.49%、1.47%、0.87%、-1.37%、-2.65%。

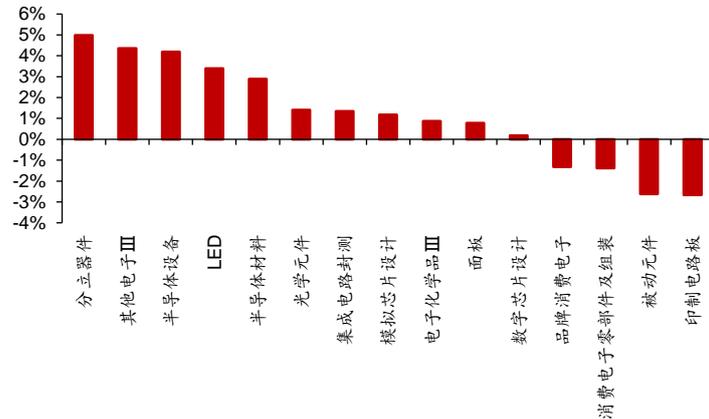
图 2：SW 电子二级行业周涨跌幅情况（07.29-08.02）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

过去一周（07.29-08.02）SW 电子三级行业中，分立器件板块上涨 4.99%，涨幅最大；涨跌幅排名后三的板块分别为印制电路板、被动元件以及消费电子零部件及组装板块，涨跌幅分别为-2.66%、-2.62%、-1.39%。

图 3：SW 电子三级行业周涨跌幅情况（07.29-08.02）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

1.2 个股表现

过去一周（07.29-08.02）涨幅前十的公司分别是中晶科技（40.78%）、盈方微（25.12%）、富瀚微（18.93%）、上海贝岭（15.65%）、商络电子（15.59%）、乾照光电（14.67%）、盛洋科技（14.65%）、达瑞电子（14.63%）、士兰微（14.25%）、锦富技术（12.80%），跌幅前十的公司分别是则成电子（-24.55%）、ST 旭电（-21.43%）、智新电子（-11.66%）、凯腾精工（-11.49%）、胜宏科技（-10.32%）、三孚新科（-10.23%）、协创数据（-9.68%）、宝明科技（-8.50%）、生益科技（-8.35%）、瀛通通讯（-7.67%）。

表 1：电子板块（SW）个股过去一周涨跌幅前 10 名（07.29-08.02）

周涨幅前 10 名			周跌幅前 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周涨幅(%)
003026.SZ	中晶科技	40.78%	837821.BJ	则成电子	-24.55%
000670.SZ	盈方微	25.12%	000413.SZ	ST 旭电	-21.43%
300613.SZ	富瀚微	18.93%	837212.BJ	智新电子	-11.66%
600171.SH	上海贝岭	15.65%	871553.BJ	凯腾精工	-11.49%
300975.SZ	商络电子	15.59%	300476.SZ	胜宏科技	-10.32%
300102.SZ	乾照光电	14.67%	688359.SH	三孚新科	-10.23%
603703.SH	盛洋科技	14.65%	300857.SZ	协创数据	-9.68%
300976.SZ	达瑞电子	14.63%	002992.SZ	宝明科技	-8.50%
600460.SH	士兰微	14.25%	600183.SH	生益科技	-8.35%
300128.SZ	锦富技术	12.80%	002861.SZ	瀛通通讯	-7.67%

资料来源：iFinD，上海证券研究所

2 行业新闻

信越化学：硅晶圆需求触底 12 寸产品出货将逐步增加

7 月 29 日，据科创板日报援引日经新闻，半导体晶圆企业信越化学表示，硅晶圆需求终于触底，预估 12 寸产品出货量在 AI 需求带动下，将自 7 至 9 月以后逐步增加。（资料来源：科创板日报）

2023H2 中国云专业和管理服务市场同比增长 13.5%

7 月 29 日，据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国云专业与管理服务市场（2023 下半年）跟踪》报告显示，2023 下半年中国云专业与管理服务市场整体规模达到 211.9 亿元人民币，同比增长 13.5%。其中，云专业服务市场规模为 156.7 亿元，同比增长 13.0%；云管理服务市场规模达到 55.2 亿元人民币，同比增长 14.9%。（资料来源：IDC 咨询）

SK 海力士拟投资近 500 亿元建设芯片工厂

7 月 29 日，据 SEMI 援引 SK Hynix 官网消息，SK 海力士发表声明，宣布将投资约 9.4 万亿韩元（约合人民币 492.56 亿元）在韩国龙仁市建设当地首座 Fab 厂和业务设施。公告显示，按照计划，SK 海力士将于 2025 年 3 月开工建设龙仁集群的首座厂房，并于 2027 年 5 月竣工。此次通过董事会获得了投资决议，该项目旨在夯实公司未来发展基础，并及时应对日益剧增的面向 AI 的半导体存储器需求。（资料来源：SEMI）

台积电将于 2028 年开始使用高 NA EUV 工具制造 A14P

7 月 29 日，据半导体产业纵横消息，台积电已经制定了使用高 NA EUV 机器的路线图，这家全球最大的纯晶圆代工厂将在 2027 年第三季度使用标准 EUV 设备将其第一代 1.4nm A14 工艺投入量产，但高 NA EUV 工具将在 2028 年早些时候用于升级后的 A14P 工艺。（资料来源：半导体产业纵横）

鸿海将在印度制造 iPhone 16 Pro 与 Pro Max

7 月 30 日，据财联社消息，鸿海将在印度制造 iPhone 16 Pro 与 Pro Max，这是首次在印度生产高阶 Pro 系列机种，苹果越来越重视印度智能手机市场以及印度手机供应链，鸿海为 iPhone 最大供应商，也是苹果印度最大代工厂，将受惠最大。（资料来源：财联社）

三星 HBM3e 先进芯片 2024 年量产，营收贡献将增长至 60%

7 月 31 日，三星电子公司计划 2024 年开始量产其第五代高带宽存储器（HBM）芯片 HBM3e，并迅速提高其对营收的贡献。三星电子表示，该公司预计其最先进的 HBM3e 芯片占总 HBM 的销售比例有望在 2024Q4 达到 60%。（资料来源：科创板日报）

台积电德国晶圆厂将于 8 月 20 日举行奠基仪式

7 月 31 日，据科创板日报消息，台积电控股子公司 ESMC 将于 8 月 20 日举行德国德累斯顿晶圆厂的奠基仪式。该晶圆厂将聚焦车用和工业用芯片，具体工艺为 28/22nm 平面 CMOS、16/12nm FinFET 等成熟制程，预计于 2027 年实现量产，月产能可达 40000 片 12 英寸晶圆。（资料来源：科创板日报）

美光量产第九代 TLC NAND 闪存技术

7 月 31 日，存储芯片大厂美光科技宣布，其采用第九代（G9）TLC NAND 技术的 SSD 现已开始出货，成为首家达成这项里程碑的企业。据介绍，美光 G9 NAND 善用业界最高 NAND I/O 速率，符合工作负载处理大量数据的高吞吐量需求，和市面上现已出货的其他 NAND SSD 产品相比，数据传输速率加快 50%；与现有 NAND 竞品方案相较，美光 G9 NAND 的每芯粒写入带宽扩大达 99%、读取带宽扩大达 88%。（资料来源：芯智讯）

海目星首条 Micro LED 中试线出货

8 月 1 日，据海目星官微消息，近日，公司首条 Micro LED 中试线出货，涵盖 Micro LED 巨量转移、Micro LED 巨量焊接、Micro LED 激光修复等设备，并已完成厂内 FAT 验收，产线效率达 25-100kk/h，制程良率达 99.99% 以上，实现 $\leq 50 \mu\text{m}$ 的 Micro LED 芯片应用要求。（资料来源：科创板日报）

Luminar 收购 G&H 激光模块部门扩大芯片业务

8 月 1 日，据集微网消息，自动驾驶汽车激光雷达传感器制造商 Luminar CEO 表示，该公司已收购英国 Gooch & Housego（G&H）的光电元件和激光模块业务，以扩大其半导体业务。Luminar 于 2023 年成立了半导体部门 Luminar Semi，此前收购了激光制造商 Freedom Photonics、定制芯片设计公司 Black Forest Engineering 和光电探测器公司 Optogration。Luminar CEO 表示，Luminar Semi 已实现收支平衡，并将在收购 G&H 部门 EM4 公司后进一步扩展到航空航天和国防领域。（资料来源：集微网）

3 公司公告

表 2：本周 A 股公司核心公告（07.29-08.02）

公告日期	公司	公告类型	要闻
2024-07-30	腾景科技	对外投资	公司基于整体发展规划的考虑，为进一步提升在光引擎方面的研发、制造能力和核心竞争力，于 2024 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 3,000 万元在武汉成立子公司，建设光引擎封装工艺技术平台以及培育规模化制造能力。近期，武汉子公司已完成了当地政府部门设立注册登记手续，并取得了颁发的《营业执照》。
2024-07-30	波导股份	股份回购	截止本公告日，公司已完成回购。实际回购公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.34%，购买的最高价格为 3.20 元/股、最低价格为 3.03 元/股，已支付的总金额为 55,490,174.00 元（不含交易费用）。
2024-07-30	华塑控股	对外投资	公司十二届董事会第十一次临时会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币 2 亿元在武汉市设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以下简称“碳索空间”），主要业务为甲烷等温室气体的监测和排放治理等。目前，碳索空间已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》。
2024-07-30	闻泰科技	权益分派	公司本次以实施权益分派股权登记日的公司总股本 1,242,809,694 股扣减回购股份 4,362,400 股后的股份 1,238,447,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），派发现金红利总额为 154,805,911.75 元（含税）。
2024-07-31	中电港	资金使用	公司拟使用超募资金 15,439.61 万元投资建设亿安仓智慧供应链项目【即华东枢纽仓（南京）】，该部分资金 15,439.61 万元将由公司通过无息借款方式，向本项目实施主体公司全资孙公司南京亿安仓供应链服务有限公司提供。
2024-08-01	瑞芯微	权益分派	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 418,300,800 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 83,660,160.00 元。
2024-08-01	恒玄科技	股份回购	截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 447,562 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.3729%，回购成交的最高价为 138.00 元/股，最低价为 99.52 元/股，支付的资金总额为人民币 51,009,761.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
2024-08-01	鸿合科技	股份回购	截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为 2,353,950 股，占截至 2024 年 7 月 30 日公司总股本的 0.9961%，最高成交价格为 22.81 元/股，最低成交价格为 19.13 元/股，支付总金额为人民币 50,067,831.90 元（不含交易费用）。
2024-08-01	歌尔股份	股份回购	截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份 39,434,946 股，占公司目前总股本的比例为 1.15%，最高成交价为 19.00 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，支付金额为 674,750,693.64 元（不含交易费用）。
2024-08-02	新相微	股份回购	截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 102.8725 万股，占公司总股本 45,952.9412 万股的比例为 0.22%，回购成交的最高价为 11.00 元/股，最低价为 8.86 元/股，支付的资金总额为人民币 9,999,098.30 元。

资料来源：iFinD，上海证券研究所

4 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧

中美贸易摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，部分公司的经营或受到较大影响。

2) 终端需求不及预期

下游终端需求不及预期，产业链相关公司业绩或发生较大波动。

3) 国产替代不及预期

国产替代不及预期，国内企业的业绩或将面临承压。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

本报告仅供上海证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。